2024中国传感器展-传感器技术展览会-国际芯片展会-人工智能芯片展会-显示芯片展会

产品名称	2024中国传感器展-传感器技术展览会-国际芯片展会-人工智能芯片展会-显示芯片展会
公司名称	中国（耀瀚）展会信息
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国
联系电话	17810353883 17810353883

产品详情

SEMI-e2024第六届深圳国际半导体技术暨应用展览会

展览时间：2024年06月26-28日展览地点：深圳市国际会展中心（宝安新馆）

如今，全球芯片制程正愈发精细化，芯片集成度、复杂度更高。芯片制造过程本就复杂，需要经过数百道工序，精细化又使得芯片制造难度更大。

因此，为保证芯片的质量，因此在芯片完成封装后会对单个芯片成品性能进行完整测试。而这一过程中所需的设备，便是测试设备。

作为全球电子制造业的中心以及全球大的消费电子市场，近年来中国半导体产业也是增长迅速，中国已经成为全球大和贸易活跃的半导体市场。据预测，到2030年我国的半导体市场供应将达到5385亿美元，其中69%的消费量将来自中国本土公司，需求主要来自数据中心、消费电子、汽车、医疗等应用领域。2024第六届SEMI-e 深圳国际半导体技术暨应用展览会以“ 芯中有算，智享未来 ”为主题，守正创新向上进阶。展示内容更为丰富，活动体验更加多元精彩，同时将聚合国际化资源，开设“ 3馆14区 ”，展会规模超60,000㎡，预计将迎来800+企业盛装亮相，展品覆盖芯片设计、晶圆制造与封装、新型显示MIni/Micro-LED、半导体专用设备、第三代半导体、电子元器件、机器视觉与传感器等全产业链，预计吸引60,000+观众到场参观。

当前，全球芯片产业正处在供不应求的境况，封测厂紧急扩张产能，对芯片测试设备的需求量暴增，众多IC设计厂也加入了抢购测试设备的行业。由此，芯片测试设备产业出现了产能紧张的状况。

这对全球芯片产业来说，并不是一件好事。但是，对中国企业来说却是一次机会。中国企业可以趁机抢下更多的订单与客户。在低端集成电路测试设备市场中，国产产品已经强下了70-80%的市场。但在中高端，我国仍受制于人。

展示范围1、设计、芯片、晶圆制造与封装：集成电路设计及芯片、晶圆制造、SiP先进封装、功率器件封测、MEMS封测、硅晶圆及IC封装载板、封装基板与应用制造与封测、EDA、MCU、封装基板半导体材料与设备及零部件等

2、先进材料：硅片及硅基材料、光掩模板、电子气体、光刻胶及其配套试剂、CMP抛光材料、靶材、封装基板、引线框架、键合丝、陶瓷基板、芯片粘合材料等

3、IC载板/陶瓷基板：IC载板及封装工艺(基板、铜等结构材料及干膜、金盐等化学品/耗材)
Chiplet封装技术、存储、MEMS及芯片应用及材料、设备。陶瓷基板与封装材料及设备等

4、半导体显示/Mini/Micro-LED：OLED、AMOLED、Mini/Micro LED显示、柔性显示与材料及设备等

5、半导体专用设备&零部件：减薄机、单品炉、研磨机、热处理设备、光刻机、刻蚀机、离子注入设备、CVD/PVD 设备、清洗设备切割机、装片机、键合机、测试机、分选机、探针台及零部件等

6、第三代半导体：氮化(GaN) 和碳化硅(SiC)、氧化锌(Zn0)、金刚石、晶圆、衬底与外延、功率器件、IGBT封装材料、射频器件及加工设备等

7、元器件：无源器件、半导体分立器件/IGBT、5G核心元器件特种电子、元器件。电源管理、传感器、储存器、连接器继电器、线缆、接插器件、晶振、电阻、显示器件、二极管、三极管滤波元件、开关及元器件材料及设备等

8、机器视觉与传感器：各类感知元件、执行器、智能传感器、工业传感器、传感器芯片、传感器生产与制造设备、配件等

9：电源&储能技术：储能电源及传感器、电池管理芯片、功率半导体器件及材料和相关设备、仪器及零部件等

10、毫米波雷达/激光雷达/自动驾驶：毫米波雷达模组、射频芯片、天线及高频PCB、高频材料、生产组装设备等汽车雷达传感器上下游供应链各环节产品等

11、微电子综合智造区：电子自动化、机器自动化、视觉检测、环保、清洗设备、检测设备、测试仪器、配件等

12、AI与算力、算法、存储、CPO共封装：人工智能芯片、方案、算力芯片及方案、算法方案数据存储、光电共封装模块及技术和设备等

13、汽车半导体/车规级先进封装技术：车规级半导体主控/计算类芯片、功率半导体(IGBT和MOSFET)、车规级siC模块、电源管理芯片、汽车电子微组装及功率器件、封装测试设备、自动化设备、国际半导体材料商、设备商、封测、制造、代工厂商等

大湾区优势：

『粤港澳大湾区」建设是指将广东省9个城市(包括广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆)及香港、澳门两个特别行政区，发展成为的城市群及具有全球影响力的国际科技创新中心。

创新能力强和开放的城市群，发展潜力巨大传统制造业聚集地：汽车制造、新能源汽车、半导体、家用电器、消费电子、电子信息及装备制造、5G材料、智能制造、高性能材料、节能环保等。

随着科技的不断进步，半导体行业的需求不断增长，对光刻机的精度和产能也提出了更高的要求。在中

国，光刻机的研发和制造也在不断发展壮大，本文将就光刻机的原理、技术发展、国内现状和未来发展趋势进行探讨。